

LCP日本宝理A460 50% 硅胶填料

产品名称	LCP日本宝理A460 50% 硅胶填料
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	50.00/kg
规格参数	品牌:日本宝理 型号:A460 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

日本宝理 LCP A460 低磨耗 加50二氧化硅LCP 注塑级应用

LCP的中文全称是液晶高分子

其特点为分子具有较高的分子量且具有取向有序LCP性能优异介电损耗低有望在5G高频信号传输中加速应用良好的挠性材料方便组合设计满足电子产品小型化的趋势要求良好的机械性能将有望拓展LCP在工程领域的应用空间

根据前瞻产业研究院数据目前全球LCP树脂材料产能约7.6万吨主要集中在日本美国和中国占比分别为45%34%和21%从具体生产企业看目前塞拉尼斯宝理塑料以及住友三家企业差能超过了1万吨前三家企业产能占比高达63%行业中度较高我国进入LCP领域较晚长期依赖美日进口近几年来随着普利特金发科技沃特股份聚嘉新材料等企业陆续投产LCP材料产能快速增长

全球 LCP 树脂厂家占比情况

LCP下游应用领域广泛需求有望保持增长根据前瞻产业研究数据2018年全球LCP需求量约7万吨随着5G技术的推进LCP市场将保持持续增长的势头预计到2020年其全球市场规模可达7.8万吨此外LCP应用领域有望不断扩宽在电子电器领域可应用于高密度连接器线圈架线轴基片载体电容器外壳等在汽车工业领域可用于汽车燃烧系统元件燃烧泵隔热部件精密元件电子元件等在航空航天领域可用于雷达天线屏蔽罩耐高温耐辐射壳体等领域未来伴随着应领域的不断拓宽LCP市场规模将不断增长

目前主流的天线基材主要是聚酰亚胺PI但是由于PI基材的介电常数和损耗因子较大吸潮性较大可靠性较差高频传输损耗严重结构特性较差已经无法适应当前高频高速的趋势因而在信号传输频率不断提升过程中MPI改性聚酰亚胺材料应运而生由于PI在高频传输过程中的限制生产企业通过将PI单体进行含氟量提升等方式对PI高聚物进行改性以满足10-15GHz的信号传输要求然而伴随更高频率的毫米波段的逐步应用MPI的传输亦将受到限制在多层板设计方面不足将逐步凸显更高频率的信号传输要求将促使LCP材料加速推广

LCP介电常数和介电损耗极低在毫米波传输中有效降低信号损耗毫米波的绕射能力较差接近于直线传播对于智能手机的天线接收方向设计有更高的要求LCP产品具有良好的电绝缘性介电常数极低具有极小的介电损耗和导体损耗在接受和发射毫米波信号时在基板材料上的损耗较小可以显著提高信号传递的质量

电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）；

b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面；c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）：作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）